2026年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年11月13日

上場会社名　　タツモ株式会社　　上場取引所　　東
コード番号　　6266　　ＵＲＬ　https://tazmo.co.jp/irlibrary/#irlib-report01
代表者　　（役職名）代表取締役社長　　（氏名）佐藤　泰之
問合せ先責任者　（役職名）常務取締役管理本部長　　（氏名）吉國　久雄　　ＴＥＬ　086-239-5000

配当支払開始予定日　　－
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無　　：無

（百万円未満切捨て）

１．2026年12月期第３四半期の連結業績（2026年１月１日～2026年９月30日）

（１）連結経営成績（累計）

（%表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年12月期第３四半期	21,127	△22.1	1,383	△68.7	1,391	△68.8	774	△75.6
2025年12月期第３四半期	27,114	9.6	4,423	△3.9	4,454	△1.5	3,175	2.6

（注）包括利益　2026年12月期第３四半期　903百万円（△65.5%）　2025年12月期第３四半期　2,616百万円（△19.1%）

	１株当たり四半期純利益	潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年12月期第３四半期	53.50	－
2025年12月期第３四半期	218.95	－

（２）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年12月期第３四半期	51,832	27,485	52.0	1,860.63
2025年12月期	46,893	27,037	56.6	1,834.03

（参考）自己資本　2026年12月期第３四半期　26,968百万円　2025年12月期　26,542百万円

２．配当の状況

	年間配当金				
	第１四半期末	第２四半期末	第３四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年12月期	－	0.00	－	34.00	34.00
2026年12月期	－	0.00	－		
2026年12月期（予想）				34.00	34.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2026年12月期の連結業績予想（2026年１月１日～2026年12月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		１株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	35,500	0.2	3,600	△24.5	3,500	△30.1	2,500	△29.4	170.65

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※　注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無
　　新規　－社　（社名）－、除外　－社　（社名）－

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
　①　会計基準等の改正に伴う会計方針の変更　：無
　②　①以外の会計方針の変更　：無
　③　会計上の見積りの変更　：無
　④　修正再表示　：無

（４）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む）	2026年12月期３Ｑ	14,842,354株	2025年12月期	14,842,354株
②　期末自己株式数	2026年12月期３Ｑ	347,918株	2025年12月期	370,046株
③　期中平均株式数（四半期累計）	2026年12月期３Ｑ	14,484,405株	2025年12月期３Ｑ	14,503,822株

※　添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．経営成績等の概況（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 …… 2
（１）当四半期の経営成績の概況 …… 2
（２）当四半期の財政状態の概況 …… 3
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …… 3
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …… 4
（１）四半期連結貸借対照表 …… 4
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …… 6
四半期連結損益計算書 …… 6
四半期連結包括利益計算書 …… 7
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …… 8
（継続企業の前提に関する注記） …… 8
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 8
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …… 8
（重要な後発事象） …… 8
（四半期連結貸借対照表に関する注記） …… 9
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記） …… 9
（セグメント情報等の注記） …… 10
３．補足情報 …… 11
（受注状況） …… 11

１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況

当第３四半期連結累計期間における経営環境は、地政学リスクの高まり、原材料の高騰や不安定な為替相場など、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループが属する半導体業界におきましては、引き続き生成AIに関連したサーバーへの設備投資が拡大しており、アドバンスドパッケージ向けの半導体装置を中心に需要が見込まれる一方、顧客の設備投資や装置の検収時期にはばらつきが見られました。

このような状況のなか当社グループは、中長期的な成長に向けて、顧客ニーズに対応した装置の開発や生産活動に注力してまいりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は211億27百万円（前年同期比22.1％減）、営業利益13億83百万円（前年同期比68.7％減）、経常利益13億91百万円（前年同期比68.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益7億74百万円（前年同期比75.6％減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

なお、2026年12月期第１四半期連結会計期間より、報告セグメント「プロセス機器事業」内の「コーター」を「半導体装置」に含めて区分しており、以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後の区分に組み替えて比較しております。

(プロセス機器事業)

半導体装置部門につきましては、出荷済み装置の検収の遅れなどが影響し、売上高は104億46百万円（前年同期比22.6％減）となりました。

搬送装置部門につきましては、受注状況は回復傾向にあり、売上高は58億28百万円（前年同期比2.4％増）となりました。

洗浄装置部門につきましては、ウェーハメーカーの設備投資が軟調である影響を受け、売上高は13億44百万円（前年同期比0.0％増）となりました。

以上の結果、プロセス機器事業の売上高は176億19百万円（前年同期比14.2％減）、営業利益15億9百万円（前年同期比57.7％減）となりました。

(金型・樹脂成形事業)

金型・樹脂成形事業につきましては、概ね計画通りであったものの、原材料の高騰や工場移転費用などの発生により、売上高は９億25百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益15百万円（前年同期比84.1%減）となりました。

(表面処理用機器事業)

表面処理用機器事業につきましては、出荷済み装置の検収遅れなどから、売上高は25億81百万円（前年同期比54.4％減）、営業損失90百万円（前年同期は７億33百万円の営業利益）となりました。

（２）当四半期の財政状態の概況

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は397億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億97百万円増加しました。主な要因は、「現金及び預金」の減少62億34百万円、「棚卸資産」の増加63億57百万円、「その他流動資産」の増加16億42百万円によるものであります。有形固定資産は108億31百万円となり、前連結会計年度末より30億18百万円増加しました。主な要因は、「機械装置及び運搬具」の増加４億４百万円、「土地」の増加19億１百万円、「その他」の増加８億20百万円によるものであります。無形固定資産は1億89百万円となり、前連結会計年度末より9百万円減少しました。主な要因は、「ソフトウエア」の減少６百万円、「その他」の減少３百万円によるものであります。投資その他の資産は11億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ32百万円増加しました。主な要因は、「繰延税金資産」の増加21百万円、「その他」の増加９百万円によるものであります。

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ49億39百万円増加し、518億32百万円となりました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は193億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ49億44百万円の増加となりました。主な要因は、「支払手形及び買掛金」の増加22億51百万円、「電子記録債務」の減少12億９百万円、「未払法人税等」の減少７億38百万円、「契約負債」の増加46億64百万円によるものであります。固定負債は50億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億54百万円の減少となりました。主な要因は、「長期借入金」の減少５億13百万円によるものであります。これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ44億90百万円増加し、243億46百万円となりました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は274億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億48百万円の増加となりました。主な要因は、「利益剰余金」の増加２億77百万円、「為替換算調整勘定」の増加１億４百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年12月期の連結業績予想につきましては、2026年２月13日に公開しました、「2025年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の2026年12月期の連結業績予想（2026年１月１日～2026年12月31日）を達成する見込みであり、変更はしておりません。

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

	前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年９月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,274,465	10,040,265
受取手形及び売掛金	3,019,861	3,561,779
電子記録債権	2,539,187	2,043,777
棚卸資産	15,410,284	21,768,258
その他	650,779	2,293,322
貸倒引当金	△84,608	－
流動資産合計	37,809,969	39,707,403
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,672,924	3,565,107
機械装置及び運搬具（純額）	1,651,827	2,056,622
土地	1,449,516	3,351,322
その他（純額）	1,038,510	1,858,533
有形固定資産合計	7,812,778	10,831,585
無形固定資産		
ソフトウエア	154,900	148,747
その他	44,566	40,950
無形固定資産合計	199,466	189,697
投資その他の資産		
投資有価証券	23,924	25,927
繰延税金資産	651,882	673,555
その他	395,188	404,472
投資その他の資産合計	1,070,995	1,103,954
固定資産合計	9,083,241	12,125,238
資産合計	46,893,210	51,832,642

（単位：千円）

	前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年９月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,565,571	3,816,809
電子記録債務	2,011,901	802,471
短期借入金	3,265,446	3,517,284
未払金	1,595,168	1,269,717
未払法人税等	912,101	173,335
契約負債	3,659,601	8,324,187
賞与引当金	337,947	669,783
製品保証引当金	638,228	494,286
株式給付引当金	11,183	8,946
その他	395,937	261,195
流動負債合計	14,393,086	19,338,017
固定負債		
長期借入金	4,645,009	4,131,790
株式給付引当金	344,706	366,520
役員退職慰労引当金	35,040	38,484
退職給付に係る負債	82,711	77,209
資産除去債務	211,336	264,452
その他	143,921	130,195
固定負債合計	5,462,724	5,008,653
負債合計	19,855,811	24,346,670
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,568,590	3,568,590
資本剰余金	3,420,931	3,423,160
利益剰余金	19,140,774	19,417,928
自己株式	△739,532	△697,426
株主資本合計	25,390,763	25,712,253
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△176	△117
為替換算調整勘定	1,152,556	1,257,096
退職給付に係る調整累計額	△486	△485
その他の包括利益累計額合計	1,151,892	1,256,493
非支配株主持分	494,741	517,223
純資産合計	27,037,398	27,485,971
負債純資産合計	46,893,210	51,832,642

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（単位：千円）

	前第３四半期連結累計期間 （自　2025年１月１日 至　2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2026年１月１日 至　2026年９月30日）
売上高	27,114,192	21,127,257
売上原価	18,601,773	14,502,541
売上総利益	8,512,418	6,624,715
販売費及び一般管理費	4,088,943	5,240,734
営業利益	4,423,475	1,383,981
営業外収益		
受取利息	54,468	128,697
補助金収入	111,728	4,233
その他	26,403	42,154
営業外収益合計	192,600	175,085
営業外費用		
支払利息	64,401	68,197
為替差損	71,145	97,595
その他	26,170	1,441
営業外費用合計	161,717	167,234
経常利益	4,454,358	1,391,832
特別利益		
固定資産売却益	16,885	－
特別利益合計	16,885	－
税金等調整前四半期純利益	4,471,243	1,391,832
法人税等	1,280,472	603,081
四半期純利益	3,190,770	788,751
非支配株主に帰属する四半期純利益	15,188	13,782
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,175,581	774,969

（四半期連結包括利益計算書）

（単位：千円）

	前第３四半期連結累計期間 （自　2025年１月１日 至　2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2026年１月１日 至　2026年９月30日）
四半期純利益	3,190,770	788,751
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△115	59
為替換算調整勘定	△573,715	114,430
退職給付に係る調整額	－	1
持分法適用会社に対する持分相当額	△61	△113
その他の包括利益合計	△573,891	114,378
四半期包括利益	2,616,879	903,129
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,645,358	879,569
非支配株主に係る四半期包括利益	△28,479	23,559

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（四半期連結貸借対照表に関する注記）

※１　期末日満期手形等の処理

期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等の金額が前連結会計年度末日の残高に含まれております。

	前連結会計年度 （2025年12月31日）	当第３四半期連結会計期間 （2026年９月30日）
電子記録債権	60,539千円	－千円
電子記録債務	718,276千円	－千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　2025年１月１日 至　2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2026年１月１日 至　2026年９月30日）
減価償却費	703,014千円	824,520千円

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　至　2025年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：千円）

	報告セグメント			合計	調整額（注）２	四半期連結損益計算書計上額（注）３
	プロセス機器事業	金型・樹脂成形事業	表面処理用機器事業			
売上高						
半導体装置	13,496,241	－	－	13,496,241	－	13,496,241
搬送装置	5,692,874	－	－	5,692,874	－	5,692,874
洗浄装置	1,343,885	－	－	1,343,885	－	1,343,885
金型・樹脂成形	－	915,058	－	915,058	－	915,058
表面処理用機器	－	－	5,666,133	5,666,133	－	5,666,133
顧客との契約から生じる収益	20,533,001	915,058	5,666,133	27,114,192	－	27,114,192
その他の収益	－	－	－	－	－	－
外部顧客への売上高	20,533,001	915,058	5,666,133	27,114,192	－	27,114,192
セグメント間の内部売上高又は振替高	238,727	50,526	－	289,253	△289,253	－
計	20,771,728	965,584	5,666,133	27,403,446	△289,253	27,114,192
セグメント利益	3,566,717	95,134	733,159	4,395,011	28,463	4,423,475

（注）１．2026年12月期第１四半期連結会計期間より、プロセス機器事業の「コーター」は「半導体装置」に含めて区分する方法に変更しておりますので、前第３四半期連結会計期間のセグメント情報についても、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2026年１月１日　至　2026年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：千円）

	報告セグメント			合計	調整額（注）２	四半期連結損益計算書計上額（注）３
	プロセス機器事業	金型・樹脂成形事業	表面処理用機器事業			
売上高						
半導体装置	10,446,863	－	－	10,446,863	－	10,446,863
搬送装置	5,828,692	－	－	5,828,692	－	5,828,692
洗浄装置	1,344,363	－	－	1,344,363	－	1,344,363
金型・樹脂成形	－	925,858	－	925,858	－	925,858
表面処理用機器	－	－	2,581,479	2,581,479	－	2,581,479
顧客との契約から生じる収益	17,619,919	925,858	2,581,479	21,127,257	－	21,127,257
その他の収益	－	－	－	－	－	－
外部顧客への売上高	17,619,919	925,858	2,581,479	21,127,257	－	21,127,257
セグメント間の内部売上高又は振替高	569,713	8,859	－	578,573	△578,573	－
計	18,189,633	934,718	2,581,479	21,705,830	△578,573	21,127,257
セグメント利益又は損失（△）	1,509,974	15,110	△90,181	1,434,904	△50,923	1,383,981

（注）１．2026年12月期第１四半期連結会計期間より、プロセス機器事業の「コーター」は「半導体装置」に含めて区分する方法に変更しております。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

３．補足情報

（受注状況）

当第３四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

１．受注高

セグメントの名称	前第３四半期連結累計期間 （自　2025年１月１日 至　2025年９月30日） （千円）	当第３四半期連結累計期間 （自　2026年１月１日 至　2026年９月30日） （千円）	前年同期比 （％）
プロセス機器事業	14,770,629	52,728,205	357.0
半導体装置	8,758,534	39,997,656	456.7
搬送装置	4,994,162	10,804,892	216.4
洗浄装置	1,017,932	1,925,656	189.2
金型・樹脂成形事業	915,629	966,361	105.5
表面処理用機器事業	2,333,193	15,828,990	678.4
合計	18,019,452	69,523,558	385.8

（注）１.2026年12月期第１四半期連結会計期間より、プロセス機器事業の「コーター」は「半導体装置」に含めて区分する方法に変更しておりますので、前第３四半期連結累計期間の受注高についても、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

２.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．受注残高

セグメントの名称	前第３四半期連結累計期間 （自　2025年１月１日 至　2025年９月30日） （千円）	当第３四半期連結累計期間 （自　2026年１月１日 至　2026年９月30日） （千円）	前年同期比 （％）
プロセス機器事業	19,642,210	52,822,033	268.9
半導体装置	14,633,301	42,393,122	289.7
搬送装置	3,026,738	7,793,197	257.5
洗浄装置	1,982,170	2,635,714	133.0
金型・樹脂成形事業	170,761	210,859	123.5
表面処理用機器事業	2,240,332	15,021,592	670.5
合計	22,053,304	68,054,485	308.6

（注）１.2026年12月期第１四半期連結会計期間より、プロセス機器事業の「コーター」は「半導体装置」に含めて区分する方法に変更しておりますので、前第３四半期連結会計期間の受注残高についても、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

２.上記の金額には消費税等は含まれておりません。